



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-227768

(43) 公開日 平成8年(1996)9月3日

(51) Int. Cl.  
H 0 1 R 33/76

識別記号

戸内整理番号  
7354-5B

F I

H 0 1 R 33/76

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全 3 頁)

(21) 出願番号 特願平7-56555

(22) 出願日 平成7年(1995)2月21日

(71) 出願人 000102500

エスエムケイ株式会社

東京都品川区戸越6丁目5番5号

(72) 発明者 吉田 光宏

東京都品川区戸越6丁目5番5号 エスエムケイ株式会社内

(72) 発明者 久田 清司

東京都品川区戸越6丁目5番5号 エスエムケイ株式会社内

(74) 代理人 弁理士 田中 雅雄

(54) 【発明の名称】 ICパッケージ用ソケット

(57) 【要約】

【目的】 装着されるICパッケージの浮き上がりを防止する。

【構成】 Jペント型のリード102を有するICパッケージが装着される装着空間12が内側に形成された枠形のインシュレーター11と、該インシュレーター11上に配置され、前記リード102に当接する接触部17及び弾性変形して前記接触部17を前記装着空間12側へ押圧する屈曲部16が形成されたコンタクト15を有するICパッケージ用ソケットにおいて、前記コンタクト15の前記接触部17に対して開口側の配座に、前記装着空間12側へ突出する凸部19を、前記ICパッケージの装着時において前記接触部17を底側へ向ける形で形成する。

